

## 半導体実装技術の国際学会「ECTC 2026」に参加

住友ベークライト株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鍛冶屋 伸一)は、5月26日から29日まで米国フロリダ州オーランドで開催される、進化する AI 半導体を含む次世代半導体実装・パッケージ技術に関する世界最大級の国際学会「IEEE 76th Electronic Components and Technology Conference (ECTC 2026)」に参加し、大学および共同研究企業とともに3件の研究成果を発表いたします。

近年、AI半導体の普及に伴い、半導体パッケージにはさらなる高性能化・高信頼性・高密度化が求められています。当社は外部パートナーとの協業を積極的に推進し、次世代半導体向け材料・技術の開発を加速しています。ECTC 2026では、こうした取り組みの成果として、光電融合パッケージ技術、ガラスパッケージ向け再配線材料、車載向け高熱伝導封止材料に関する研究成果を発表いたします。

### 発表内容

#### ■ 光電融合 RDL インターポーザ技術(東北大学との共同研究)

Technical Session 33 日時: 5月29日(金)14:00-17:05

多機能光硬化性ポリマーを用いた統合型 CPO 向け光学 RDL インターポーザ技術を提案し、ポリマー導波路およびハイブリッド接合に関する技術実証を行ないました。

#### ■ ガラスパッケージ向け低誘電 RDL 材料(ジョージア工科大学との共同研究)

Technical Session 27 日時: 5月29日(金)9:30-12:35

低硬化収縮性・低温硬化性・低誘電特性を有する液状感光性材料により、ガラス基板上で高密度 Cu 再配線層を形成し、マイクロビアを有する多層配線の初の実証に成功しました。

#### ■ 車載向け高熱伝導封止材料(SPIL/MediaTek との共同研究)

Technical Session 9 日時: 5月27日(水)14:00-17:05

樹脂設計とフィラー配合の最適化により、高い熱伝導性と信頼性を両立した車載半導体向け封止材料を開発しました。高密度車載パッケージの高信頼性 AEC-100 に貢献する技術成果です。

住友ベークライト株式会社は、プラスチックの可能性を追究し、価値創造を通じて、環境や社会、そして人びとの暮らしに貢献しています。今後も先端材料技術の開発を通じて、グローバル市場におけるプレゼンス向上を目指すとともに次世代半導体の進化に貢献いたします。

### ECTC 2026 開催概要

名称: IEEE 76th Electronic Components and Technology Conference (ECTC 2026)

会期: 2026年5月26日(火)~5月29日(金)

会場: JW Marriott & The Ritz-Carlton Grande Lakes(米国フロリダ州オーランド)

WEB: <https://ectc.net/>

### 【問い合わせ先】

住友ベークライト株式会社 情報通信材料営業本部

TEL: 03-5462-4015

お問い合わせフォーム [https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j\\_company](https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j_company)

このリリースに関するお問い合わせは  
コーポレート・コミュニケーション部  
広報担当まで

〒140-0002  
東京都品川区東品川2丁目5-8  
天王洲パークサイドビル

TEL (03) 5462-4818  
FAX (03) 5462-4876  
E-MAIL [info@sumibe.co.jp](mailto:info@sumibe.co.jp)